强一半导体（苏州）股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码：688809　　公司简称：强一股份

第一节　重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本129,559,300股，以此计算合计拟派发现金红利129,559,300.00元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.81%。自本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司年度股东会审议批准。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节　公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	强一股份	688809	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张子涵	李紫雯
联系地址	苏州工业园区东长路88号S3幢	苏州工业园区东长路88号S3幢
电话	0512-80168808	0512-80168808
传真	无	无
电子信箱	ir@maxonesemi.com	ir@maxonesemi.com

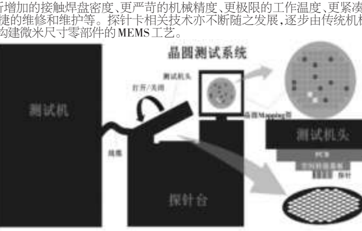
2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断。根据QYResearch估算，2025年公司占全球半导体探针卡市场份额已达3.87%，公司在全球探针卡厂商中的排名为第6位。

探针卡是一种应用于半导体生产过程晶圆测试阶段的"消耗型"硬件，是半导体产业基础支撑元件。作为晶圆制造与芯片封装之间的重要节点，晶圆测试能够在半导体产品构建过程中实现芯片制造缺陷检测及功能测试，对芯片的设计具有重要的指导意义，能够直接影响芯片良率及制造成本，是芯片设计与制造不可或缺的一环，对半导体产业链具有重要意义。因此，在人工智能、数字化技术不断革新的趋势下，探针卡的性能是保障在通信、计算机、消费电子、汽车电子以及工业等领域发挥决定性作用的半导体产品可靠性的重要基础之一。

具体而言，探针卡是晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，实现芯片与测试设备的信号连接。完成测试后，晶圆被分成单个单元，以便进入下一个生产阶段。随着芯片性能的不断发展，晶圆测试要求不断提升：更为极端的电气性能、显著减小的接触焊盘间距、不断增加的接触焊盘密度、更严苛的机械精度、更极限的工作温度、更紧凑的生产周期、同时测试多个芯片的高并行性以及更便捷的维修和维护等。探针卡相关技术亦不断随之发展，逐步由传统机械加工方式发展为综合了先进激光技术和光刻工艺以构建微米尺寸零部件的MEMS工艺。



资料来源：网络公开信息，公司整理

公司核心产品覆盖2D MEMS探针卡、2.5D MEMS探针卡、薄膜探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡等全系列探针卡，同时配套提供探针卡维修服务及晶圆测试板等关键部件。产品广泛应用于SoC、CPU、GPU、射频、存储、CIS、汽车电子、人工智能等芯片的晶圆测试环节，是保障芯片良率与制造效率的核心耗材。凭借技术自主化与国产替代优势，公司已进入主流半导体企业供应链，客户包括芯片设计、晶圆代工及封装测试领域头部企业，产品覆盖非存储高端芯片领域并持续向HBM、DRAM、NAND Flash等存储芯片领域拓展。

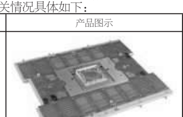
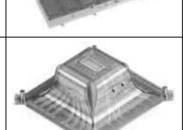
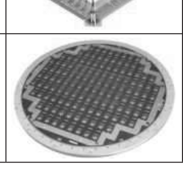
根据探针的制造是否采用了MEMS工艺，公司探针卡产品可以分为MEMS探针卡和非MEMS探针卡。

（1）MEMS探针卡

公司掌握MEMS探针制造、MEMS探针检测、空间转接基板深加工、探针卡结构及装配方面的核心技术，拥有探针卡设计及装配、探针卡PCB设计、空间转接基板设计及深加工、MEMS探针设计及制造等专业技术能力，并提供探针卡维修及保养等服务。

公司MEMS探针卡主要包括2D MEMS探针卡、薄膜探针卡及2.5D MEMS探针卡。其中，2D MEMS探针卡是基于MEMS探针技术制造的垂直探针卡，主要由MEMS探针、导引板、空间转接基板、PCB以及机械结构部件构成，其每一支探针通过MEMS工艺制造；薄膜探针卡是基于MEMS技术制造的薄膜与探针一体化的探针卡，主要由薄膜MEMS探针、PCB、机械结构部件构成，其探针内嵌于薄膜中；2.5D MEMS探针卡是基于MEMS探针技术制造的微悬臂探针卡，主要由MEMS探针、空间转接基板、内嵌板、PCB以及机械结构部件构成，其每一支探针通过MEMS工艺制造。根据QYResearch估算，公司在MEMS探针卡这一高技术壁垒的细分领域表现更为突出，2025年在全球MEMS探针卡厂商中排名第5位。

公司MEMS探针卡相关情况具体如下：

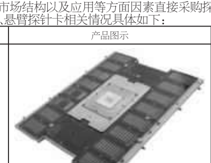
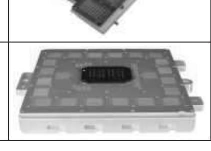
产品名称	产品图示	产品特点	主要应用领域
2D MEMS探针卡		系公司自研MEMS探针卡中最早实现量产的产品，具有装针数量大、耐电流高、测试寿命长、测试间距小、测试性能稳定、易于维护等特点，目前公司最先进的2D MEMS探针卡可以应用于境内最先进制程芯片的晶圆测试	手机AP、CPU、GPU、FPGA、ASIC、其他SoC等
薄膜探针卡		系公司又一款实现量产的自研MEMS探针卡，具有测试频率高、测试性能稳定、测试寿命长等特点	射频芯片、光电子芯片等
2.5D MEMS探针卡		具有并测数高、装针数量大、植针面积大等特点	HBM、NAND Flash、DRAM等存储芯片以及CIS芯片等

（2）非MEMS探针卡

公司掌握垂直探针卡、悬臂探针卡装配方面的核心技术，拥有探针卡设计及装配、探针卡PCB设计、空间转接基板设计及深加工等专业技术能力，并提供探针卡维修及保养等服务。

公司垂直探针卡装配经机械加工制造的探针，主要由钯合金探针、导引板、空间转接基板、PCB等构成。公司悬臂探针卡装配经机械拉伸弯折的探针，主要由钨合金或钯合金探针、PCB、机械结构部件等构成。由于非MEMS探针机械加工技术较为成熟，公司基于技术、市场结构以及应用等方面因素直接采购探针进行探针卡的生产。

公司垂直探针卡、悬臂探针卡相关情况具体如下：

产品名称	产品图示	产品特点	主要应用领域
垂直探针卡		具有测试寿命长、测试性能稳定等特点	手机AP、电源管理芯片、射频收发器芯片、其他SoC等
悬臂探针卡		具有成本低、生产周期短、测试寿命长等特点	NOR Flash、EEPROM等存储芯片、CIS、MCU等

（3）晶圆测试板以及芯片测试板

报告期内，公司存在根据客户需求直接销售半导体测试板的情形，主要包括晶圆测试板以及芯片测试板等。半导体测试板具有高层数、高厚径比、高平整度、高可靠性、小间距及精细线路的特点。其中，晶圆测试板系探针卡所需的PCB，公司根据业务需要将晶圆测试板进一步装配为探针卡产品或直接销售；芯片测试板系用于成品测试环节的PCB，主要包括成品测试的负载板、老化测试板等。

2.2主要经营模式

（1）盈利模式

公司专注于探针卡的研发、设计、生产与销售，主要通过直接向客户销售探针卡及相关产品、提供探针卡维修服务等实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入为探针卡销售、探针卡维修服务以及晶圆测试板销售；其他业务收入主要为与半导体测试相关的材料及设备的销售以及废液处置收入等。

（2）研发模式

公司建立了规范的《研发管理制度》，形成了全方位的、适应公司所处行业要求的研发模式。公司围绕行业发展趋势和客户需求，以提升产品性能、丰富产品种类为出发点，结合自身发展规划，在技术预研、技术开发、产品预研、新产品开发以及产品升级等方向进行研发布局。

①商业计划书开发及项目立项

由市场或产品管理专家担任负责人进行商业计划书的开发，商业计划书应包含市场分析、产品定义和执行策略等。商业计划书完成并经评审后，由项目负责人填写研究开发项目立项决议、研发项目情况表等文档。

②概念及计划阶段

组建项目团队，根据商业计划书，对市场机会、需求、质量、潜在的技术和制造方法、风险、成本、进度预测和财务影响等进行评估，并完成对开发方法的正式规划，由项目负责人制定《概念及计划阶段计划》。本阶段设置了3个技术评审点，分别系TR（Technical Review，技术评审）1、TR2、TR3，按顺序分别对产品/技术需求、设计需求和产品/技术概念，系统设计和规格制定，概要设计三个阶段进行技术评审，当一个阶段的评审获批准后才可进入下一阶段。三个阶段的评审均获批准后，项目团队制定开发验证主计划，最终进入概念及计划阶段的决策评审，获批准后进入开发阶段。

③开发阶段

开发阶段的目标是产品/技术包的开发，能够输出供验证的样品/原理样卡。在此阶段，项目团队按照项目进展及时编制样品/原理样卡开发及测试、小试涉及的过程性文档。本阶段设置了3个技术评审点，分别系TR4、TR4A、TR5，其中TR4、TR4A按顺序分别在完成详细设计及单元测试后，以及完成系统级功能测试和少量的性能测试后进行技术评审；当完成全部系统级的功能及性能测试后进行TR5评审，获批准后进入验证阶段。

④验证阶段

验证阶段的目标是产品是否能够满足客户需求，确定最终的规格及相关文档，确定各功能领域已经准备就绪，输出的是最终的产品。在此阶段，项目团队按照项目进展及时编制中试、量产等涉及的过程性文档。本阶段设置了1个技术评审点TR6，主要对制造能力、量产计划等进行技术评审。TR6获批准后进入可获得性决策评审阶段，如获批准则进入发布阶段。

（3）设计、生产模式

公司依据客户需求等进行产品的设计、生产，主要采取以销定产的经营模式。经技术积累，公司拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产MEMS探针卡，在各类探针卡领域形成了较为成熟的设计、生产模式，在形成产品所需的关键工艺环节逐步凝练了专业能力、积累了关键技术，具体如下：

项目	MEMS探针卡		非MEMS探针卡	
	2D/2.5D MEMS探针卡	薄膜探针卡	垂直探针卡	悬臂探针卡
探针设计及制造能力	√	√	–	–
探针卡PCB设计能力	√	√	√	√
空间转接基板设计能力	√	不涉及	√	不涉及
探针卡设计能力	√	√	√	√
探针卡装配能力	√	√	√	√

（4）采购模式

公司根据业务需要主要采购空间转接基板、PCB、探针头及MEMS探针制造材料、机械结构部件、探针、线材及元器件等原材料，以及研发设备、生产设备等固定资产。公司建立了《采购管理制度》，明确了采购流程的具体工作与审批要求，对采购工作实施全流程管理，对供应商进行合格供应商名录管理。公司采购流程主要包括需求部门请购与审批、采购部门选择供应商、与供应商签订采购合同/订单、相关部门进行签收或验收，采购部门依照合同/订单以及具体工作与审批要求进行付款申请。

（5）销售模式

公司销售模式基本为直销。公司与诸多境内知名半导体产业厂商建立了稳定的合作关系。由于探针卡产品具有高度定制化特征，为了保证产品技术及工艺符合客户测试需求，公司通过直销模式可以与客户建立良好的沟通机制和全面的客户关系，协同进行测试方案的设计与执行，确保产品满足客户的技术参数、测试要求等。通过直销模式，公司加快对客户需求的响应速度，通过和客户的及时沟通，加深对于行业变化的理解，有助于了解行业发展趋势，从而及时开展技术改进和创新。

此外，由于探针卡核心组件探针具有消耗性，在使用探针卡时需要维护或更换探针，以保证测试的可靠性，公司向客户提供探针卡维修以及保养服务。同时，公司根据客户需求提供半导体测试板。

流程上，公司销售部门负责销售计划的制定、新客户开发及客户维护、产品定价、销售合同的签订、订单接收、下达发货通知、销售退回经办、与客户对账等工作。销售部门结合公司发展战略、经营目标编制年度销售计划。公司定期对各产品或服务的销售额、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状及时调整销售计划。销售部门负责维护现有客户、开发潜在目标客户，并对客户进行档案管理。在进行销售定价时，销售部门根据财务目标、营销目标、产品成本、市场状况及竞争对手情况等多方面因素，确认产品定价；公司需评价销售产品市场及对应供应商等情况，适时调整产品价格。经商务谈判、内部评估等流程后，公司就业务合作取得正式销售合同或销售订单。生产完成后，销售助理在系统中提起发货。当产品发货后，销售人员需要根据合同/订单条款及时跟进收款。客户发现产品质量问题时，由售后人员进行维修判断，进行现场维修或返厂维修。

2.3所处行业情况

（1）行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

①公司所属行业

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于"C 制造业"中的"C39计算机、通信和其他电子设备制造业"。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于"1、新一代信息技术产业"中的"1.2 电子核心产业"中的"1.2.1 新型电子元器件及设备制造"。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的"鼓励类"产业。

②行业发展阶段与基本特点

半导体产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是全球科技竞争的关键领域。探针卡作为晶圆测试环节的核心耗材，是连接晶圆制造与芯片封装的关键节点，直接影响芯片良率、测试效率与制造成本，对半导体产业链自主可控具有重要意义。

全球探针卡行业长期由境外厂商主导，在国产化替代的背景下，中国市场规模快速增长。一直以来，半导体探针卡行业均由境外厂商主导，2023年以前，全球前十大半导体探针卡厂商均为境外企业。我国半导体行业整体起步较晚，在各个环节仍然存在不同程度的进口依赖，进而导致我国半导体探针卡行业发展存在一定滞后。据QYResearch数据估算，2025年全球前十大探针卡厂商合计占据了全球市场约80%的份额，其中FormFactor（美国）、Technoprobe（意大利）、MJC（日本）三家巨头合计占据了全球约50%的市场份额。2025年我国半导体探针卡市场规模约占全球的16.9%，但国产探针卡厂商占全球市场份额的比重约为6.12%，公司在全球份额已达3.87%，并居全球前六位。随着供应链安全和国产替代加速，中国市场规模快速增长。2025年全球半导体探针卡市场规模预计为36.40亿美元，2032年将达73.13亿美元，2026-2032年复合增长率为8.45%。2025年中国半导体探针卡市场规模约6.15亿美元，2032年将增至15.92亿美元，年复合增长率高达12.41%，中国增速预计快于全球。从国产化情况来看，2025年中国国内市场国产化率约为27%，国产替代趋势明显。

③主要技术门槛

探针卡行业作为半导体产业链中的关键环节，呈现出技术密集、资本密集及高度定制化的显著特征。行业融合了材料、热力学、力学、光电及机械等多学科前沿技术，MEMS工艺实现了探针卡从传统机械加工向微米级精密制造的跨越，对高端复合型人才提出了极高要求。随着半导体先进制程与封装技术的演进，探针卡正朝着超密集间距、高频测试及高并行性等方向快速迭代，其研发与制造紧密依赖龙头客户的牵引与验证。同时，鉴于晶圆测试对芯片性能的决定性作用及技术保密的严苛需求，行业形成了极高的客户粘性与准入壁垒；加之光刻机、刻蚀机等昂贵设备的巨额前期投入及持续的研发资金需求，使得新进入者面临较大的资金与技术挑战。

探针卡行业属于技术密集型行业，具有高复杂性、高精密型等特点。探针卡所需的探针、PCB、空间转接基板等均系精密部件，尤其是MEMS工艺综合了先进激光技术以及光刻工艺以构建微米尺寸精密部件，相关部件的设计、制造技术均具有很高难度。探针卡的研制是材料、热、力、光、电、机械等多学科的综合和交错，从材料、热、力、电的仿真到产品机械结构和电路的设计，再到MEMS工艺涉及的光刻、刻蚀、电化学沉积、研磨、匀胶显影、激光刻蚀等制造工艺，均需要大量的高端技术人才和具备多学科知识基础以及行业知识的复合型人才。

探针卡产品迭代需紧跟半导体先进技术发展。随着半导体技术的发展，探针卡技术向着超密集间距、多引脚数量、超多测试次数以及超高频测试等方向不断发展，探针卡产品的迭代升级需要行业龙头客户的牵引与容错。探针卡是晶圆测试设备与待测晶圆之间的必要媒介，实现芯片与测试设备的信号连接。完成测试后，晶圆被分成单个单元，以便进入下一个生产阶段。随着芯片性能的不断发展，晶圆测试要求不断提升：更为极端的电气性能、显著减小的接触焊盘间距、不断增加的接触焊盘密度、更严苛的机械精度、更极限的工作温度、更紧凑的生产周期、同时测试多个芯片的高并行性以及更便捷的维修和维护等。随着先进制程和先进封装等半导体技术发展，探针卡相关技术亦不断随之发展，逐步由传统机械加工方式发展为综合了先进激光技术和光刻工艺以构建微米尺寸零部件的MEMS工艺。

探针卡行业定制化程度高，技术保密要求高，客户粘性强。不同客户的不同芯片具有不同测试需求，因此不同探针卡厂商的技术特点因客户、产品结构等不同而存在差异。晶圆测试是可以影响客户产品质量、性能的关键工序，因此客户对于晶圆测试的供应商选取较为严苛，需要对探针卡产品进行严格的验证，且验证周期可能随探针卡制造技术难度的提升而延长。客户与探针卡厂商建立合作后，如进行供应商调整时将一定程度增加时间及良率损失的成本。其次，由于测试指标、参数可以直接反映芯片制造的技术秘密，出于对核心技术等的保密考虑，客户更愿意与供应商建立稳定、持续的合作以减少相关技术泄密的风险。因此，新进入者与客户快速建立合作并能够持续、稳定地服务客户的门槛较高。

探针卡行业属于资本密集型行业。例如，MEMS工艺制造探针过程中需要用到光刻机、刻蚀机、电镀设备、研磨机、激光设备等先进且昂贵的设备，前期投入大、投资风险高，需要企业保持较高的营运资金水平。另外，由于半导体技术的不断发展以及探针卡高度定制化的特征，厂商需要持续保持较高研发投入和人才投入以应对不断发展和差异化的测试需求。

（2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是一家专注于服务半导体设计与制造的高新技术企业，聚焦晶圆测试核心硬件探针卡的研发、设计、生产与销售。公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在高端MEMS探针卡领域的垄断，具备显著的国产化替代优势。根据QYResearch数据估算，2025年公司位列全球探针卡行业第6位，是近年来唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。2025年公司在全球MEMS探针卡厂商中排名第5位。公司成立以来先后获得多项奖项、荣誉或科研平台认定，包括国家级专精特新"小巨人"企业、高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、苏州市"独角兽"培育企业等。

探针卡行业属于技术、资金及智力密集型行业，具有较高壁垒。该行业长期由境外厂商主导，由于进入市场较早，相关厂商技术实力强、经营规模大、研发投入高。近年来，全球前十大探针卡厂商合计市场份额仍保持在80%左右，行业集中度较高。全球第一梯队格局稳定，FormFactor、Technoprobe、MJC稳居全球前三，具备显著规模与技术优势。公司凭借MEMS探针卡业务的快速增长，2024年、2025年持续位居全球前六名，打破了长期由美欧日垄断的格局，成为全球前十中唯一的中国大陆企业。第二、三梯队厂商排名相对变动较为频繁，主要包括中国台湾、韩国及其他境内厂商。

与国际龙头相比，境内厂商在综合规模、产品矩阵及全球化服务能力方面仍存在一定差距，但伴随国内半导体产业高速发展、供应链自主可控需求提升，公司凭借技术研发、定制化服务、快速响应及本地化优势，在高端探针卡领域实现持续突破，国产替代进程不断加快。根据QYResearch数据测算，2025年公司全球市场份额已提升至3.87%以上，在中国大陆厂商中占据主导地位。

全球探针卡厂商市场占有率排名情况

梯队	公司名称	国家/地区	成立年份	是否上市	市场排名（2025年）	简介
第一梯队	Technoprobe	意大利	1996	是	1	欧洲领军者。SoC测试的领导者，同时布局高端存储测试领域，是Samsung和SK Hynix的供应商。
	FormFactor	美国	1993	是	2	全球龙头。MEMS探针卡技术的奠基者，客户覆盖Intel、Samsung、TSMC等。
	MJC	日本	1970	是	3	日系代表。在显示驱动芯片（DDIC）和部分存储测试中占据主导。
第二梯队	旺矽科技	中国台湾	1995	是	4	台系龙头。业务覆盖集成电路、射频毫米波及硅光子芯片测试领域，在存储与光电测试领域具备竞争优势。
	JEM	日本	1960	是	5	日系代表。深耕存储半导体测试领域，在DRAM和NAND Flash测试探针卡领域具有竞争力。
	强一股份	中国	2015	是	6	中国大陆本土厂商中的领头羊，在MEMS探针卡领域增长迅速，是唯一进入全球前十的中国大陆厂商。
	Nidec SV Probe Pte. Ltd	新加坡	1994	否	7	母公司为日本电产（Nidec Corporation）。在功率半导体、MEMS及悬臂探针卡领域技术先进。

资料来源：QYResearch，公开信息搜集并经整理

当前，国产替代加速推进、芯片制程持续升级、先进封装普及以及国内晶圆厂产能扩张，共同驱动高端探针卡需求快速增长。随着芯片向7nm/5nm/3nm先进制程演进，SiP、SoC、HBM等技术路线快速发展，晶圆测试对高密度、高性能、高可靠性探针卡的需求持续提升，为公司带来广阔的市场空间。同时，探针卡具有高度定制化特征，需要与客户深度协同，公司凭借本地化服务优势与快速响应能力，产品渗透率有望持续提升。

公司是国内少数拥有自主MEMS探针制造技术并实现规模化量产的探针卡厂商，已打破境外厂商在高端MEMS探针卡领域的长期垄断。目前公司客户覆盖境内外芯片设计、晶圆代工、封装测试等产业链核心企业，累计服务客户超400家，包括众多国内头部半导体企业及知名芯片厂商，客户资源壁垒突出。

（3）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

①公司所处探针卡行业发展情况及趋势

2022年下半年以来，集成电路行业进入下行周期，经过2023年的低位徘徊，2024年以来行业呈现复苏态势。据WSTS数据，预计2025年全球半导体市场达7720亿美元，2026年全球半导体市场增长超过25%，达到9750亿美元。据Omdia预测，受全球AI大基建的推动和数据中心大规模部署带来高性能存储芯片需求的暴涨，预计2026年中国半导体市场增长31.26%，市场规模将达到5465亿美元。

晶圆厂扩产、供应链安全下高端测试订单回流和先进制程芯片测试前置共同驱动探针卡渗透率提升。据SEMI预测，到2028年，全球将新建108座晶圆厂，其中亚洲84座，中国占47座。测试环节已约占芯片总成本的25-30%，且供应链安全需求驱动国产替代加速，2018年后中国大陆芯片设计公司将高端测试订单向国内回流。随着先进制程演进到5nm、3nm和先进封装如CoWoS、HBM的兴起，为了避免将高成本的芯片封装成废品，需要在晶圆阶段进行更严格、更复杂的测试。

据QYResearch估算，2025年全球半导体探针卡市场规模大约为36.40亿美元，预计2032年将达73.13亿美元，2026-2032期间年复合增长率达8.45%。2025年中国半导体探针卡市场规模约6.15亿美元（占全球16.90%），预计未来六年中国市场复合增长率为12.41%，并在2032年规模达到15.92亿美元，中国增速预计快于全球。MEMS探针卡在市场占主导地位，在全球MEMS探针卡市场占比超70%。探针卡技术向超密集间距（<45μm）、超高频（220GHz）、超长寿命（100万次）方向演进。

②探针卡在非存储领域应用趋势

非存储领域是公司探针卡的核心应用市场，主要包括手机、人工智能、汽车电子、工业控制等芯片的晶圆测试环节。随着人工智能技术普及、高性能计算需求提升以及汽车、工业等终端市场稳步恢复，非存储领域芯片需求持续增长，带动高端探针卡需求同步增加。

在手机应用领域，芯片朝高密度、高集成度方向发展，对探针卡的精度、稳定性要求不断提高。在人工智能与算力领域，GPU、NPU等高性能芯片快速发展，对探针卡的高频信号传输、测试精度与可靠性提出更高要求，为具备技术优势的厂商带来更大发展空间。

③探针卡在存储领域应用趋势

报告期内，存储芯片市场需求逐步回暖，产品价格与销量同步回升，市场景气度持续改善。DRAM、NAND Flash等主流存储芯片的晶圆测试，主要采用2.5D/3D MEMS探针卡。受人工智能产业发展驱动，HBM3E、HBM4等高端存储芯片堆叠层数持续提升，带动HBM探针卡价值量显著提高。同时，随着CoWoS、Foveros等先进封装技术快速普及，芯片测试向更小节距、更高集成度方向发展，垂直探针卡与MEMS探针卡成为行业主流解决方案。

④探针卡的技术要求和趋势

探针卡的性能升级向更多针数、更高效率、更快频率、更高良率、更长寿命、更加精密、更低成本等方向发展。探针卡针数向20万针以上突破，支持Chiplet多芯片测试；薄膜探针卡向110 GHz以上频率演进，满足新一代光电芯片测试需求；探针寿命提升至100万次，共面性控制在10μm以内。同时，行业正在探索电化学剥离技术以提升贵金属回收率，通过干法清洗、AI能效调度降低能耗，应对碳足迹管理要求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,461,462,905.75	1,276,659,017.97	249.46	960,014,756.49
归属于上市公司股东的净资产	4,066,045,724.91	1,122,597,991.65	262.20	883,707,848.22
营业收入	1,012,104,477.17	641,360,442.97	57.81	354,439,114.34
利润总额	441,562,414.60	257,563,943.50	71.44	16,910,084.11
归属于上市公司股东的净利润	394,924,921.76	233,097,013.39	69.43	18,657,720.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,120,220.83	227,049,160.37	72.26	14,392,806.68
经营活动产生的现金流量净额	384,757,388.33	279,671,584.34	37.57	48,397,018.84
加权平均净资产收益率(%)	29.92	23.30	增加6.62个百分点	2.15
基本每股收益(元／股)	4.06	2.40	69.17	0.19
稀释每股收益(元／股)	4.06	2.40	69.17	0.19
研发投入占营业收入的比例(%)	13.06	12.25	增加0.81个百分点	26.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	86,470,274.87	287,931,841.52	272,677,534.08	365,024,826.70
归属于上市公司股东的净利润	14,043,710.13	123,840,626.75	111,895,605.84	145,144,979.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,553,253.08	124,137,021.17	111,599,255.04	142,830,691.54
经营活动产生的现金流量净额	112,350,460.54	13,502,354.78	100,568,537.28	158,336,035.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,532
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
周明	0	27,138,156	20.95	27,138,156	无	0	境内自然人
新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）	0	8,540,000	6.59	8,540,000	无	0	其他
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,385,200	5.70	7,385,200	无	0	其他
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	0	6,219,000	4.80	6,219,000	无	0	其他
王强	0	4,500,000	3.47	4,500,000	无	0	境内自然人
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,273,300	3.30	4,273,300	无	0	其他
海風投資有限公司	0	3,010,890	2.32	3,010,890	无	0	境外法人
聯發利寶（香港）有限公司	0	2,474,300	1.91	2,474,300	无	0	境外法人
新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,450,000	1.89	2,450,000	无	0	其他
新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,450,000	1.89	2,450,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，周明与新沂强一、王强为一致行动人；新沂强一、众强行一、知强合一均为周明控制的其他企业，系公司持股平台。在董事任职方面，丰年君和、哈勃科技及元禾璞华分别提名一名外部董事在公司任职。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：上表中公司股东王强与控股股东、实际控制人周明的一致行动关系已于2026年3月31日到期终止，相关股份不再合并计算，周明实际控制公司34.06%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股东一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-022）。

存托凭证持有人情况

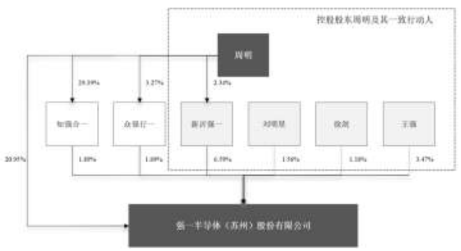
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

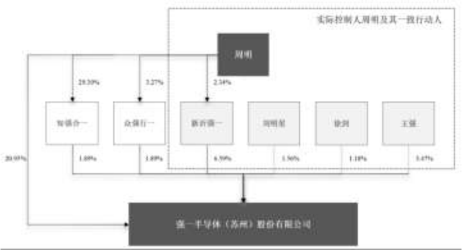
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节　重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入101,210.45万元，同比增长57.81%，实现归属于上市公司股东的净利润39,492.49万元，同比增长69.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,112.02万元，同比增长72.26%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：688809　　证券简称：强一股份　　公告编号：2026-035

强一半导体（苏州）股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日　14点 00分

召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园J栋会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案	√
4	关于董事2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《强一半导体（苏州）股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》以及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

（下转B120版）

强一半导体（苏州）股份有限公司

2026第一季度报告

证券代码：688809　　证券简称：强一股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	284,828,466.10	86,470,274.87	229.39
利润总额	124,996,700.44	17,888,890.88	598.74
归属于上市公司股东的净利润	112,012,161.97	14,043,710.13	697.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,844,418.46	12,553,253.08	782.99
经营活动产生的现金流量净额	69,834,733.71	112,350,460.54	-37.84
基本每股收益(元/股)	0.86	0.14	514.29
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.14	514.29
加权平均净资产收益率(%)	2.72	1.24	增加1.48个百分点
研发投入合计	34,575,729.41	31,188,101.37	10.86
研发投入占营业收入的比例(%)	12.14	36.07	减少23.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,562,524,769.40	4,461,462,905.75	2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	4,180,121,563.28	4,066,045,724.91	2.81

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-55,992.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	250,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,093,427.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,635.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	135,325.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,167,743.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	229.39	本期业绩大幅增长，主要系： 1、受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加半导体行业整体景气上行周期，下游客户测试需求旺盛，公司成熟MEMS探针卡产品订单持续放量。 2、2025年度已发货但尚未满足收入确认条件的存量订单，于2026年第一季度按照企业会计准则相关规定确认收入，对本期业绩形成正向贡献。 3、公司客户结构优化，订单质量与稳定性持续提升；同时随着业务规模扩大，规模效应逐步显现。
利润总额	598.74	
归属于上市公司股东的净利润	697.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782.99	
研发投入占营业收入的比例(%)	减少23.93个百分点	主要系报告内营业收入较上年同期上升过快所致
基本每股收益(元/股)	514.29	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升所致。
稀释每股收益(元/股)	514.29	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-37.84	主要系与上年同期相比，购买商品劳务、支付职工薪酬增加较多，同时销售商品收到现金的增速低于营业收入增速。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,532	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周明	境内自然人	27,138,156	20.95	27,138,156	0	无	0
新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,540,000	6.59	8,540,000	0	无	0
宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,385,200	5.70	7,385,200	0	无	0
深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,219,000	4.80	6,219,000	0	无	0
王强	境内自然人	4,500,000	3.47	4,500,000	0	未知	0
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,273,300	3.30	4,273,300	0	无	0
海風投資有限公司	境外法人	3,010,890	2.32	3,010,890	0	无	0
聯發利寶（香港）有限公司	境外法人	2,474,300	1.91	2,474,300	0	无	0
新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2,450,000	1.89	2,450,000	0	无	0
新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	2,450,000	1.89	2,450,000	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司—广发中小盘精选混合型证券投资基金	849,451	人民币普通股	849,451
华夏银行股份有限公司—广发成长启航混合型证券投资基金	731,345	人民币普通股	731,345
交通银行股份有限公司—工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金	621,266	人民币普通股	621,266
中国工商银行股份有限公司—汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	526,505	人民币普通股	526,505
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
上海浦东发展银行股份有限公司—汇添富双利增强债券型证券投资基金	401,400	人民币普通股	401,400
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	328,881	人民币普通股	328,881
中国工商银行股份有限公司—金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	303,041	人民币普通股	303,041
上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	235,863	人民币普通股	235,863
招商银行股份有限公司—广发价值核心混合型证券投资基金	235,696	人民币普通股	235,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前10名股东持股情况中，周明与新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人；新沂强一企业管理合伙企业（有限合伙）、新沂市众强行一企业管理合伙企业（有限合伙）、新沂市知强合一企业管理合伙企业（有限合伙）均为周明控制的其他企业，系公司持股平台。 在董事任职方面，宁波丰年荣通投资管理有限公司—宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）及元禾璞华（苏州）投资管理有限公司—江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）分别提名一名外部董事在公司任职。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：上表中公司股东王强与控股股东、实际控制人周明的一致行动关系已于2026年3月31日到期终止，相关股份不再合并计算，周明实际控制公司34.06%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分股东一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-022）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：强一半导体（苏州）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,710,249,541.74	2,739,440,039.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,120,125.79	160,084,230.06
衍生金融资产		
应收票据	234,630.00	1,055,516.93
应收账款	335,302,005.47	336,855,118.74
应收款项融资	16,159,000.00	284,904.40
预付款项	36,274,246.02	23,868,449.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,657,142.08	8,642,222.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,918,618.91	176,995,493.40
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,330,687.70	28,776,893.46
流动资产合计	3,455,245,997.71	3,476,002,868.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	618,098,398.87	545,954,401.42
在建工程	292,870,757.23	296,204,242.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,505,458.39	23,526,202.03
无形资产	26,964,417.22	25,523,409.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,246,733.25	26,321,743.33
递延所得税资产	24,037,931.04	22,590,600.76
其他非流动资产	98,555,075.69	45,339,437.79
非流动资产合计	1,107,278,771.69	985,460,037.07
资产总计	4,562,524,769.40	4,461,462,905.75
流动负债：		
短期借款	94,061,520.50	100,065,737.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,993,124.29	125,208,706.88
预收款项		
合同负债	5,954,429.40	5,277,770.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,154,174.49	36,210,500.83
应交税费	28,912,461.83	29,681,646.70
其他应付款	22,639,648.11	39,985,958.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,644,232.17	9,652,157.37
其他流动负债	32,514,423.36	27,136,978.76
流动负债合计	361,874,014.15	373,219,456.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,013,299.30	14,487,626.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,515,892.67	7,710,097.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,529,191.97	22,197,724.25
负债合计	382,403,206.12	395,417,180.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	129,559,300.00	129,559,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,329,257,311.83	3,327,193,635.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,277,389.21	65,277,389.21
一般风险准备		
未分配利润	656,027,562.24	544,015,400.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,180,121,563.28	4,066,045,724.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,180,121,563.28	4,066,045,724.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,562,524,769.40	4,461,462,905.75

公司负责人：周明　　主管会计工作负责人：仇春琦　　会计机构负责人：仇春琦

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：强一半导体（苏州）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	284,828,466.10	86,470,274.87
其中：营业收入	284,828,466.10	86,470,274.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,781,508.24	71,886,359.80
其中：营业成本	101,014,004.26	27,672,104.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	819,060.36	306,878.67
销售费用	4,036,639.38	2,335,922.54
管理费用	19,610,558.96	9,754,212.03
研发费用	34,575,729.41	31,188,101.37
财务费用	-274,484.13	629,140.63
其中：利息费用	717,899.33	335,545.26
利息收入	411,470.73	228,098.66
加：其他收益	6,017,949.33	3,614,892.09
投资收益（损失以"-"号填列）	973,301.32	635,257.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	120,125.79	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-83,504.81	1,590,881.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,037,771.39	-2,333,177.53
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-55,992.79	-69,992.54
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	124,981,065.31	18,021,776.15
加：营业外收入	26,000.00	36,000.00
减：营业外支出	10,364.87	168,885.27
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	124,996,700.44	17,888,890.88
减：所得税费用	12,984,538.47	3,845,180.75
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	112,012,161.97	14,043,710.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	112,012,161.97	14,043,710.13
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	112,012,161.97	14,043,710.13
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,012,161.97	14,043,710.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	112,012,161.97	14,043,710.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.86	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.86	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周明　　主管会计工作负责人：仇春琦　　会计机构负责人：仇春琦

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：强一半导体（苏州）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,021,059.90	260,133,428.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	656,314.06	
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,236.37	2,612,529.46
经营活动现金流入小计	316,091,610.33	262,745,957.94
购买商品、接受劳务支付的现金	131,564,252.05	67,831,919.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,850,179.42	38,918,052.23
支付的各项税费	21,299,584.15	29,347,842.11
支付其他与经营活动有关的现金	18,542,861.00	14,297,683.5
经营活动现金流出小计	246,256,876.62	150,395,497.40
经营活动产生的现金流量净额	69,834,733.71	112,350,460.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,120,983.26	744,747.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,696,712.54	2,435,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,584,833.58	1,150,000.00
投资活动现金流入小计	827,402,529.38	534,329,747.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,882,435.00	130,713,335.26
投资支付的现金	740,000,000.00	570,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	892,882,435.00	700,713,335.26
投资活动产生的现金流量净额	-65,479,905.62	-166,383,587.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	453,690.69	
筹资活动现金流入小计	453,690.69	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,516.67	32,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,547,145.42	1,984,815.91
筹资活动现金流出小计	29,069,662.09	2,017,315.91
筹资活动产生的现金流量净额	-28,615,971.40	9,982,684.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,354.19	-3,297.39
五、现金及现金等价物净增加额	-24,290,497.50	-44,053,740.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,731,940,039.24	222,184,530.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,707,649,541.74	178,130,790.34

公司负责人：周明　　主管会计工作负责人：仇春琦　　会计机构负责人：仇春琦

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月27日